

300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden

21.08.2023

PI 11315

- Investitionssumme rund eine Milliarde Euro
- Grundstück ca. 100 000 m²
- Gesamtnutzfläche (aktuell) ca. 72 000 m² Fertigungs- und Büroflächen
- Reinraumfläche aktuell ca. 10 000 m², derzeit Erweiterung um ca. 3 000 m²
- Mitarbeitende ca. 480 im August 2023
- Gesuchte Berufsqualifikationen Experten aus der Halbleiterindustrie, wie Prozess-, Produktions- oder Instandhaltungsingenieure, Mathematiker, Softwareentwickler sowie Berufserfahrene und Absolventen aus Studienrichtungen wie Physik, Chemie und Mikrosystemtechnik
- Fertigungstechnologie Hochautomatisierte Halbleiterproduktion (300-mm-Siliziumsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 65nm)
- Gefertigte Produkte Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), Leistungshalbleiter

MEMS Fertigung auf
300mm Wafern (SOP in 2026)

- Einsatzgebiete der Halbleiter Überwiegend in der Automobilelektronik und Industrieanwendungen

- Vernetzte Produktion In der Halbleiterfabrik in Dresden entstehen Produktionsdaten im Umfang von 250Mbyte / Sekunde, das entspricht dem Datenvolumen von 400 parallellaufenden Videos in HD.

- Förderung Der Bau der Halbleiterfabrik in Dresden wurde durch die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des ersten „IPCEI Mikroelektronik“ (Important Project of Common European Interest on Microelectronics) gefördert. Zuwendungsgeber war das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Bosch will in den nächsten Jahren im Rahmen seines eigenen Investitionsplans und innerhalb des zweiten europäischen Förderprogramms „IPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologie“ rund drei Milliarden Euro an den Standorten Dresden und Reutlingen investieren.